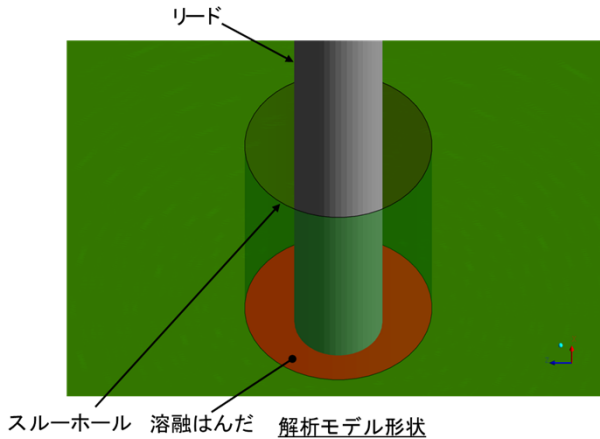


Pbフリーはんだプロセス 流動・凝固シミュレーション



スルーホール内にはんだを充填する際の充填状態をシミュレーションします。
充填と同時にはんだが温度硬化して凝固が進行していく様子や、最終的な凝固形状をシミュレーションすることにより、Pbフリーはんだプロセスの最適条件を検討することができます。



使用ソフト : ANSYS/fluent

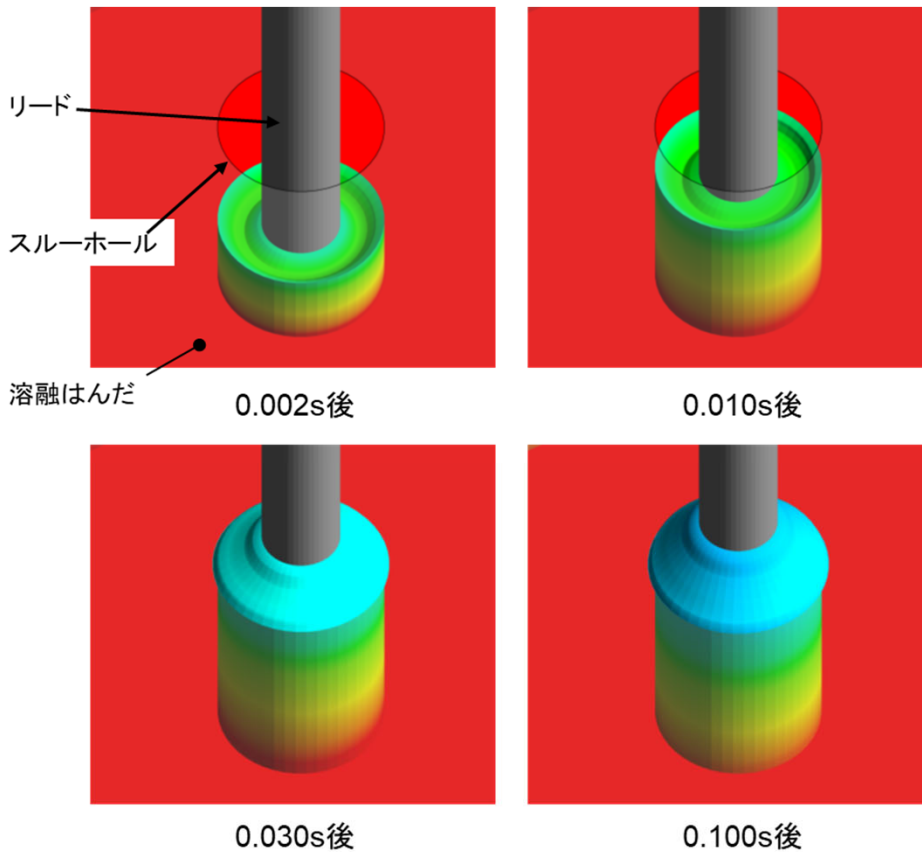
解析モデル : VOFモデル

⇒ 空気, はんだの二相流

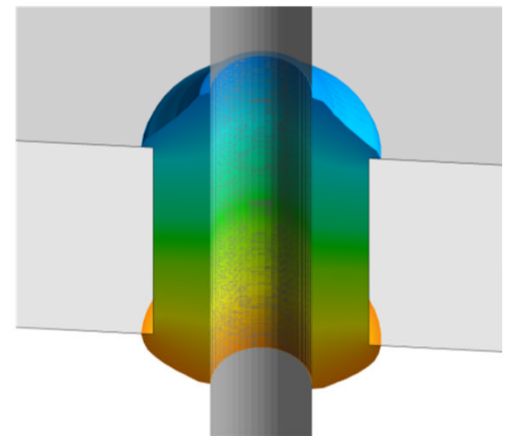
⇒ はんだの凝固を考慮

⇒ はんだの表面張力・接触角を考慮

フローハンダ時の流動・伝熱・凝固解析によって、スルーホール内のはんだの流入パターン、凝固状態、基盤も含めた温度分布を予測



流入パターンと温度分布



断面内温度分布と凝固形状

この技術資料に関するお問い合わせは、最寄り営業担当に連絡いただくか、もしくは弊社問合せ窓口までお知らせください。
。 mailto:inquiry_eigyo@kki.kobelco.com